

# Fiche d'application n°50 <sup>V2</sup>

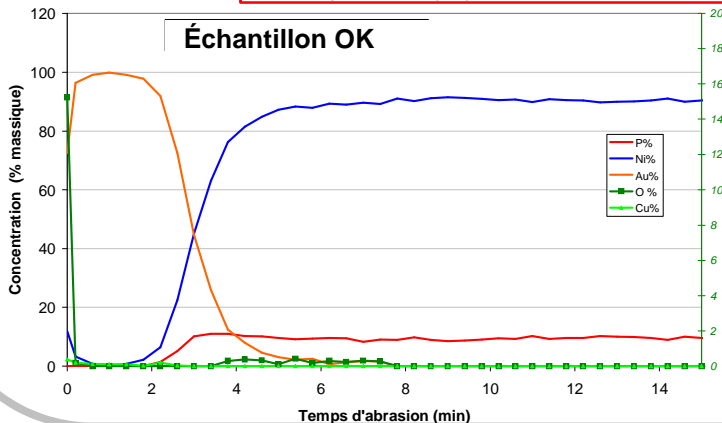
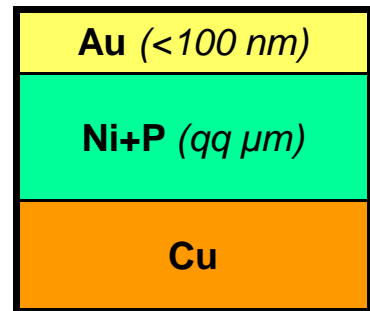
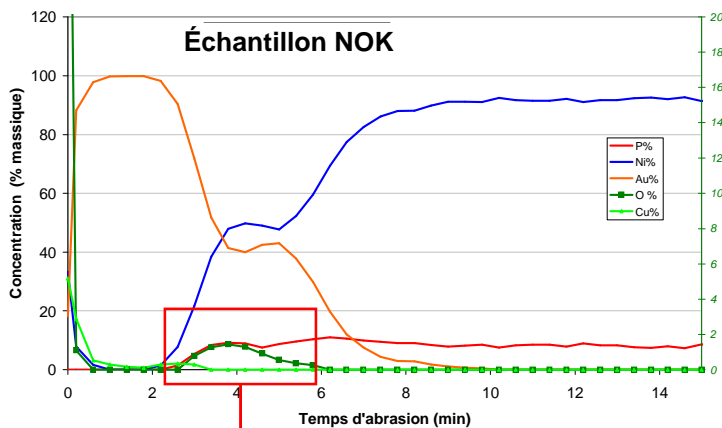
## Défauts de soudabilité de composants sur un PCB

**Objet :** Recherche de l'origine d'un défaut de soudabilité de composants sur un PCB

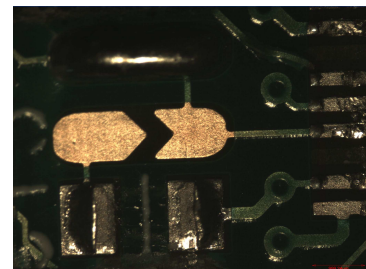
**Technique mise en œuvre :** **XPS**

- ✓ Profil quantitatif de répartition en profondeur
- ✓ Epaisseur des couches: de quelques centaines de nm à quelques  $\mu\text{m}$

### Résultats :



Oxydation à l'interface entre la couche d'or et le revêtement NiP



Empilement Cu/NiP/Au

### Conclusion :

Le défaut de soudabilité s'explique par un phénomène d'oxydation du matériau localisé à l'interface couche d'or/revêtement NiP.